

第2世代Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載 PCI-E(x16)×4、PCI-E(x8)×2装備



画像処理・マシンビジョン向け ラックマウント型PC
IPC-C621DAI-R4

- 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ搭載
- デュアルCPU搭載時、最大40コア(80スレッド)搭載
※Gold 6230プロセッサ
- インテル® C621チップセット装備
- 最大4TBメモリー(DDR4)搭載可能
- 4基のPCI-E(x16)シグナルが使用可能
- 2基のPCI-E(x8)シグナルが使用可能
- 信頼性の高いニプロン電源を搭載



☑ 第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを2基搭載

IPC-C621DAI-R4には、14nm世代の最新CPU「第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ」を2CPU搭載しています。上位モデルのXeon® Gold 6230を選択すると最大40コア80スレッド(2CPU搭載時)になります。

☑ 最大4基のPCI-E(x16)シグナル、最大2基のPCI-E (x8)シグナルが使用可能

最大4基のPCI Express x16スロット(x16シグナル)と2基のPCI Express x8スロット(x8シグナルGen 3.0)を装備。すべてのPCI Expressは、CPU側とダイレクトに接続しています。拡張ボードはPCH側を経由せず直接CPUと高速通信ができます。ハイエンドGPUやフレームグラバードなどを搭載しても処理速度の低下を招くことはありません。

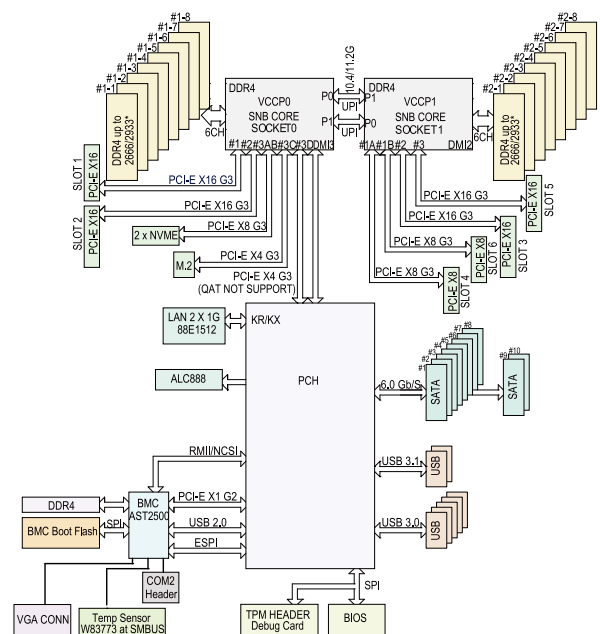
■製品仕様

モデル	IPC-C621DAI-R4	
プロセッサ	種類	第2世代 インテル® Xeon® スケーラブルプロセッサ 【長期供給性 有】 Gold 6230 (20 コア 40 スレッド、2.10GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP125W) Gold 6226 (12 コア 24 スレッド、2.70GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP125W) Gold 5215 (10 コア 20 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.40GHz、TDP85W) Silver 4215 (8 コア 16 スレッド、2.50GHz、ターボ・ブースト時 3.50GHz、TDP85W) 【長期供給性 無】 Gold 6234 (8 コア 16 スレッド、3.30GHz、ターボ・ブースト時 4.00GHz、TDP130W) Gold 6128 (6 コア 12 スレッド、3.40GHz、ターボ・ブースト時 3.70GHz、TDP115W) Gold 5222 (4 コア 8 スレッド、3.80GHz、ターボ・ブースト時 3.90GHz、TDP105W)
	搭載数	2
チップセット	インテル® C621 チップセット	
メモリー	規格	DDR4 2666MHz
	容量	標準 32GB (8GB × 4) ※最大 4TB
	スロット数	16
ストレージ	5 インチベイ	3
	3.5 インチベイ	外部 1、内部 4(空き 2) ※標準：システム用 480GB SSD × 1 (2.5 インチ変換マウントを使用。最大 2 台まで搭載可能) ※標準：データ用 1TB HDD × 1
	スリムドライブベイ	1
	SATA コネクタ数	10 (空き 8) (SATA 3.0) ※標準：SSDx1、HDDx1 で使用
グラフィックス	Aspeed AST2500 BMC	
I/O	VGA	1
	USB	前面 2 (USB2.0) / 背面 1 (USB3.1、TypeC)、1 (USB3.1、TypeA)、4 (USB3.0)
	LAN	2 (GbE)
	Audio	背面 6 (SPDIF-out, Surround-out, CEN/LFE-out, Mic-In, Line-in, Line-out)
拡張スロット	SLOT7 : None SLOT6 : PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU2 側) ※ メモリスロットと位置が重なるため、カード長に制限あり SLOT5 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU2 側) SLOT4 : PCI-Express x8 スロット (Gen 3.0、x8 シグナル、CPU2 側) SLOT3 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU2 側) SLOT2 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU1 側) SLOT1 : PCI-Express x16 スロット (Gen 3.0、x16 シグナル、CPU1 側)	
外形寸法	4U ラックマウント W430mm × D546mm × H176mm(突起物を除く)	
重量	TBC	
電源	V-Serialize V1300 Platinum	
利用環境	入力電圧	AC90V ~ 240V
	温度	10℃ ~ 35℃
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)
保管環境	温度	-10℃ ~ 55℃
	湿度	20% ~ 80% RH (結露なきこと)

■拡張スロット



■ブロック図



■I/Oポート



HPCシステムズ株式会社 CTO事業部
〒108-0022 東京都港区海岸3-9-15 LOOP-X 8階
営業時間: 9:00~18:00(土日、祝日、年末年始を除く)

TEL: 03-5446-5535 mail: cto_sales@hpc.co.jp

WEBサイト: <https://embe.hpc.co.jp/>

会社名及び製品名は、当社及び各社の商標または登録商標です。価格、写真、仕様等は予告なく変更する場合があります。製品の色調は実際と異なる場合があります。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Intel Viviv、Intel Viviv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Atom、Intel Atom Inside、Intel Core、Core inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viviv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。AMD、AMD Radeon™、Radeon™ は、Advanced Micro Devices, Inc. の商標です。Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

2020年1月現在の内容です。